

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**PCB-honor, Single-pair-Ethernet**

Single Pair Ethernet är en teknik som endast kräver ett kabelpar för att överföra data och ström.

Fördelarna med detta gör SPE till det bästa valet av nätverk på fältet och generellt.

Fördelar med Single Pair Ethernet:

- Konsekvent: SPE möjliggör enhetlig Ethernet-baserad kommunikation från givaren till molnet
- Framtidssäkert: nyckelteknologi för industri 4.0 och IIoT
- Flexibelt: räckvidd på upp till 1000 m och överföringshastigheter på upp till 1 Gbit/sek möjliggör ett brett användningsområde
- Innovativt: lägre vikt, mindre utrymmesbehov och enklare installation

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M8 PCB insats, IP67 med kapsling, SMD-lödslutning, 180°, Antal poler: 2
Art.nr.	2795110000
Typ	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
Förp.	100 Stück

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	14,5 mm	Byggdjup (tum)	0,571 inch
Höjd	22,1 mm	Bygghöjd (tum)	0,87 inch
Bredd	10,1 mm	Byggbredd (tum)	0,398 inch
Nettovikt	5,14 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------

Systemspecifikationer

Anslutningsvinkel	180°	Antal poler	2
Effektkategori	T1-B	Kategori	T1-B
Lödprocess	Reflow-lödnings, Manuell lödning	Montering på kretskortet	SMD-lödanslutning
Produktfamilj	Industriellt Ethernet	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	≥ 100		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	≥ 500 MΩ	Märkspänning	72 V
Märkström	4 A		

Standarder

Kontaktdon Norm	IEC 63171-5
-----------------	-------------

Packaging

VPE-längd	327 mm	VPE-bredd	327 mm
VPE-höjd	52 mm		

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isolationshållfasthet	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontakttyta	Ni/Au
Driftstemperatur, min.	-40 °C	Driftstemperatur, max	85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

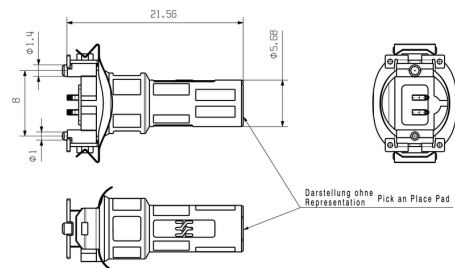
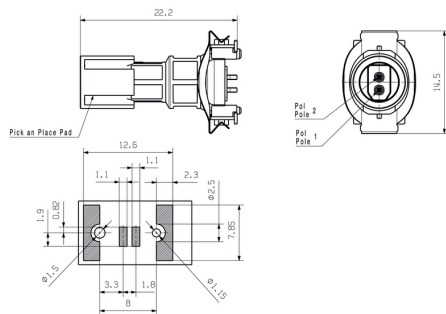
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknisk dokumentation	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.